

# C205

宽波段等离子光学图案晶圆检测系统用以发现半导体芯片上影响良率和可靠性的缺陷

## 优势：

C205可以对关键缺陷进行高灵敏度的检测并加以分类，帮助汽车芯片制造商：

- 通过表征和优化新工艺、设计节点和元件来加快研发和减少产品量产前爬坡的周期时间
- 实施缺陷减少策略来满足芯片的质量要求
- 采集可靠性缺陷的准确和可操作的数据，用以减少芯片过度筛选
- 检测和表征小于设计规则的缺陷，避免其成为逃逸的潜在缺陷

## 技术：

- 可调节DUV、UV、可见光宽波段光照光源
- 可选光学光圈
- 低噪音传感器
- NanoPoint™技术
- 先进的缺陷检测算法
- 自动缺陷分类

## 应用：

- 为研发和量产前爬坡提供系统性的缺陷侦测
- 工艺窗口认证
- 为持续改进提供工艺变化验证
- 需要高灵敏度的关键工艺层在线监控

## 市场：

用于汽车、物联网、5G、消费电子、工业（军事、航空航天、医疗）的较大设计节点元件的芯片制造

## 平台：

- 可定制的配置
- 可扩展
- 可升级

## 晶圆尺寸：

- 300mm
- 200mm



更多信息：[www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-c205](http://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-c205)